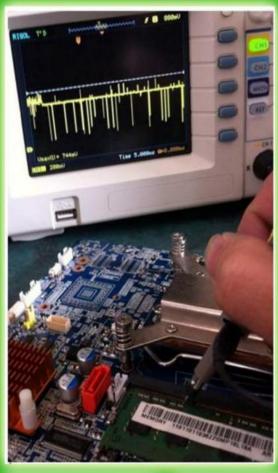
The Best of



Laptop Chip Level Repair Guide











http://www.XiuFix.com

Contenido:

Capítulo 1: Introducción a la	reparación de portátiles
-------------------------------	--------------------------

Capítulo 1: Introducción a la reparación de portátiles			
1.1 El nivel de mantenimiento/reparación de computadoras portátiles12			
1.2 Los conocimientos básicos que debe conocer antes de comenzar a reparar una computadora portátil.14			
Capítulo 2: Números de pieza de la placa base del portátil original y OEM			
2.1 Cuantos			
2.2 Complemento			
2.3 Wistron19			
2.4 Inventec			
2.5 Pegatrón20			
2.6 Samsung21			
2.7 Manzana			
2.8 Otros fabricantes22			
Capítulo 3: La arquitectura de la placa base del portátil			
3.1 La arquitectura de Intel Double Bridges (GM/PM45 e inferior)			
Capítulo 4: La explicación de los sustantivos y conceptos comunes de			
Mantenimiento de portátiles			
4.1 Fuente de alimentación y señal35 4.2Nivel alto y nivel bajo37 4.3 Salto ypulso37 4.4 La señal delreloj38			

4.5 Señal de reinicio	39
4.6 Buena señal de alimentación	
4.7 Señal Abierta (Señal de Arranque)	40
4.8 Señal de selección de chip	41
4.9 Explicación del nombre/símbolo de la señal para los fabricant base de portátiles	•
• 4.9.1 Wistron	41 • 4.9. 2
cuantosAsus	
Comp DELL	
ManzanaInventec	
Pad (IBM)53	
Capítulo 5: El circuito básico de aplicación de la elec	etrónica
Componentes	
5.1 El circuito de aplicación básica del condensador	
Capítulo 6: El uso del diagrama de circuito y el mapa de bita (Vista del tablero)	s de puntos
6.1 El uso del diagrama de circuito	75 6.2 EI
uso del mapa de bits de punto común (software BoardView)	80
Capítulo 7: Introducción de EC y BIOS89	
7.1 Las condiciones de trabajo y las funciones de ECLas funciones y condiciones de trabajo del BIOS	

Capítulo 8: El proceso de trabajo básico de la computadora portátil

8.1 El proceso general de la computadora portátil . 101 8.1.1 Proceso de arranque duro y temporizacion lintel	
suaveespecificación ACPI	
Resumen ACPIG (Global) de ACPI	
(Dispositivo) Estado de ACPI 8.2.4 Estado S (reposo) de ACPI	112
8.2.5 C Estado de ACPI	
PWRGD y el circuito de reinicio	116 8.3.1 EI
circuito del reloj	116 8.3.2 PWRGD y el circuito d

Capítulo 9: La explicación del circuito PWM

9.1 La introducción del circuito PWM	126
9.1.1 Introducción al principio de funcionamiento de PWM	126
9.1.2 El significado de la abreviatura común en inglés en el circuito	PWM130
9.1.3 El circuito Boot-Strap	
Regulación de la tensión de salida Circuito	
9.1.5 El circuito de detección de voltaje	132 134
9.1.7 El modo de trabajo	135 9.2
Análisis de la potencia de reserva Chip	137 9.2.1
Análisis de MAX8734A	137 9.2.2
Análisis de TPS51125	148 9.2.3
Análisis de RT8206A/RT8206B	155 9.3
Análisis del poder de la memoria Chip de suministro	162
9.3.1 Análisis de ISL88550A	162 9.3.2
Análisis de RT8207	
Análisis del Chip de Fuente de Alimentación Bridge/BUS	172
9.4.1 Análisis del controlador PWM único RT8209	172 9.4.2
Análisis del controlador Dual PWM TPS51124	
del núcleo de la CPU Fuente de alimentación	
9.51 Las características de la fuente de alimentación CPU VCORE	
9.5.2 Análisis de MAX8770	
9.5.3 Análisis de ISL6260	192
9.5.4 Análisis del chip de uso común ISL95831 por la placa base H	
Análisis del chip ISL6265 comúnmente utilizado por la plataforma A	MD215

Capitulo 10. Arialisis del circulto de la piaca base de la co	imputadora portatii Quanta OEM
10.1 Análisis del circuito RTC Quanta CT6	
Capítulo 11: Análisis del circuito de la placa base de OEM Wistron 11.1 A	la computadora portátil Análisis del circuito de
aislamiento de protección Wistron HBU16-1.2	2 Análisis del circuito de
Capítulo 12: Análisis del circuito de la placa base de la co	mputadora portátil OEM de Compal
12.1 Análisis del aislamiento de protección Compal LA-5891P y reserva	
Análisis del circuito de aislamiento de protección Compal LA-663 Análisis del circuito de aislamiento de protección Compal LA-675	
Capítulo 13: Análisis de la placa base de la computad Circuito	lora portátil OEM de Inventec
13.1 Análisis del circuito de aislamiento de protección de Inventer Análisis del circuito de reserva de Inventec DosXX Dunkel 1.0 circuito de características de Inventec	305 13.3 Análisis del 309 13.3.1 Análisis del
Capítulo 14: Análisis de la secuencia de encendido de INT	EL PCH (i3/i5/i7)
14.1 Acerca de Intel ME e Intel AMT	319 14.2
Análisis de la secuencia de temporización del conjunto de chips	de la serie Intel
HM55325 14.3 Análisis de la secuencia de tempo por encima de la serie Intel HM65	

Capítulo 15: Análisis de la secuencia de tempo	prización de ASUS K42JR (HM5x)
15.1 El estado de espera	333 15.2
Disparador	
estado de arranque	
Reloj, PG y Reset	359
Capítulo 16: Análisis de la secuencia de tiemp	oo de Apple A1286 (HM5x)
16.1 Estado G3	
16.2 Circuito RTC	370 16.3
Estado S5	371 16.4
Gatillo	378 16.5
Estado S3 y S0	379 16.6 EI
Reloj, PG y El Reset	393
Capítulo 17: Análisis de la secuencia de tempo 17.1 Estado G3	
Capítulo 18: Análisis de la secuencia de tempo	orización de ThinkPad (IBM) T410
18.1 Estado G3	
18.2 Estado S5	
18.3 AMT	
Gatillo Estado S3 y S0	
PG y Reset	463 18,7 El circuito de carga
	400

de la batería468

Capítulo 19: Análisis de la secuencia de tiempo de la plataforma AMD

19.1 La secuencia de temporización estándar de nVIDIA 19.2 La explicación de la secuencia de temporización del chipset nV	
16352)	481 19.3 La
temporización estándar Secuencia de chipset AMD	501 19.4
La secuencia de temporización del chipset AMD (ACER 4235, Quan	ta ZQE)503 19.5
La explicación de AMD A70M (Lenovo G485, Compal LA-8681P)5 RTC506	
aislamiento de protección	508 19.5.3 La
fuente de alimentación de reserva	512 19.5.4
El interruptor de gatillo	519 19.5.5
Producir fuente de alimentación	521
19.5.6 Fuente de alimentación de la APU	528
19.5.7 Reloj, PG y Reset	529
19.5.8 La secuencia de temporización de trabajo de gráficos indeper	ndientes534

Capítulo 20: Análisis del circuito de carga de la batería de la computadora portátil

	utilizado normalmente en la plataforma Intel542 20.1.1 El
nombre y la definición de El Pin	543 20.1. 2 Circuito de
aplicación	546 20.2 Análisis del chip
de carga ISL88731 utilizado habitualmen	te por Intel GM45 549 20.2.1 El nombre y la definición
del pin de ISL88731	
aplicación	553

Capítulo 21: Mantenimiento de fallas comunes

21.1 Problema de cortocircuito (Problema de cortocircuito) .	556
21.2 No activar fallo	
apagado	564 21.4 Fallo de no
ejecución (SIN código de error)	567 21.5 EI
Mantenimiento del código común	574 21.6 La
pantalla muestra un error	581 21.7 La
falla de la tarjeta de sonido	587
21.8 Fallo USB	591 21.9
La falla de la tarjeta de red	592 21.10
Fallo de interfaz SATA	595 21.11 La falla
de la interfaz del ventilador	597 21.12 Fallo
de colisión	599

Capítulo 22: Ejemplo de mantenimiento (casos de reparación de portátiles)

22.1 El ejen	ıplo de	mantenimient	o sobre fa	lla de	arranque
--------------	---------	--------------	------------	--------	----------

Ejemplo 1 IBM T61 no puede arrancar	. 600
Ejemplo 2 Entrada de agua de Lenovo G480, lo que provoca que no pueda arranca	
Ejemplo 3 caída de un rayo porque el Lenovo Z360 no arranca	
Ejemplo 4 IBM R60 sin modo de espera	610
Ejemplo 5 ASUS A42J con fallo múltiple	
Ejemplo 6 ASUS K42JR sin espera619	
Ejemplo 7 Acer Aspire 4738G apagado	
Ejemplo 8 ASUS K42JR Apagado622	
Ejemplo 9 SONY NS90HS no puede arrancar después de la caída de un rayo	624
Ejemplo 10 Apagado de Lenovo Xuri 410M626	
Ejemplo 11 DELL N4030 I3 no activado	
Ejemplo 12 Toshiba L500 no puede arrancar	. 631 Eiemplo
13 Samsung R23 no puede arrancar	00 · _jop.o
To carried by N20 no passes arranear	
22.2 El ejemplo del mantenimiento de averías sobre no brillante	
Ejemplo 14 Lenovo G460 no ejecuta código 641 l	Ejemplo 15 DELL
V130 no se muestra después de encenderlo 644 Ejemplo 16 S	amsung R428
sin pantalla después de encender 645 Ejemplo 17 Inventec HP511	sin pantalla y
apagado648 Ejemplo 18 Entrada de agua en eMachines D725,	que no produce
luz 651 Ejemplo 19 Lenovo G470 sin voltaje de CPU	
Ejemplo 20 Lenovo Y430 sin reloj y sin pantalla	
Ejemplo 21 Acer 5750G arrancando pero sin mostrar	657
22.3 Los ejemplos de mantenimiento de fallas de apagado	
	_
El ejemplo 22 utilizó el osciloscopio para reparar la falla de apagado de Lenovo G45	00
Ejemplo 23 Lenovo G550 el modo de espera es anormal y se apaga 661	
Ejemplo 24 HP 4411S se apaga cuando ingresa al sistema 664	
Ejemplo 25 Acer Aspire 4310 apagado	
Ejemplo 26 Lenovo Zhao yang E43G se apaga después de activarse 671 E	ejemplo 27 HP
510 se apaga repetidamente y se reinicia después de iniciarse 672	
Ejemplo 28 Lenovo V450 se apaga cuando se inicia	
Ejemplo 29 HP 4411 Apague repetidamente después de encender 676	
22.4 Los ejemplos de mantenimiento de otras fallas	
Figure 10 Contacion vita granda en ACLIC ACE al instalanta hatraía	
Ejemplo 30 Cortocircuito grande en ASUS A8E al instalar la batería 678	

Para reparar el nivel de la señal del portátil, debe saber cómo medir y analizar las señales de la placa base. Entonces, la solución perfecta para la reparación de computadoras portátiles es: ¡Reparación de nivel de componentes + nivel de señal!

1.2: Los conocimientos básicos que debe saber antes de comenzar a reparar una computadora portátil

- 1) Los conocimientos básicos de reparación electrónica que debes conocer:
 - a) Los circuitos analógicos y digitales.
 - b) ¿Cuáles son los circuitos abiertos, cortocircuitos, circuitos de fuga, etc. c) Para el reparador de computadoras portátiles, debe saber cuál es la "señal" y la "temporización" secuencia".
 - I. Señal = Cuando la placa base de una computadora portátil funciona, enviará y recibe diferentes datos y comandos para controlar los circuitos. Entonces el La señal es muy importante para que la placa base de una computadora portátil funcione correctamente.
 - II. Secuencia de tiempo = El significado de Secuencia de tiempo es como el nombre de "Timing" y la "Secuencia". Cuando la placa base de una computadora portátil le suministre una CA, presione el botón de encendido hasta que se inicie o se abra correctamente para que funcione. Al mismo tiempo, la placa base, cada circuito enviará y recibirá las señales entre su sincronización y secuencia correctas, para iniciar/abrir con éxito la placa base y que esté lista para ser utilizada por el usuario. La secuencia de tiempo es importante y debe seguirse. Si falta uno de los pasos o la sincronización es incorrecta, la placa base no funcionará. Incluso los mercados tienen computadoras portátiles de muchas marcas, pero todas o la mayoría de ellas solo usan el conjunto de chips de la plataforma Intel o AMD. Entonces, el mismo conjunto de chips está usando la misma secuencia de tiempo para funcionar. Y luego podemos aprender estas dos secuencias de tiempo principales del conjunto de chips, podemos manejar y reparar la computadora portátil fácilmente.

Capitulo 2

Ordenador portátil original y OEM Números de pieza de la placa base

Todas las computadoras portátiles de marca como Acer, Dell, HP, Lenovo, etc., no fabrican la placa base / placa base de su computadora portátil. Todos ellos están utilizando la placa base de la computadora portátil de diseño de la compañía de terceros para construir su propia computadora portátil de marca. Esto se debe a que la empresa de computadoras de marca quiere ganar más dinero y reducir el costo de construir una computadora portátil.

Todo el fabricante de la placa base de la computadora portátil de terceros lo llamó una empresa/fabricante OEM. ¿Cuál es la diferencia con la empresa OEM (fabricante de equipos originales) y ODM (fabricante de diseño original)?

La empresa OEM es responsable de fabricar el producto, pero no incluye el diseño ni la investigación del producto. Pero la compañía ODM está haciendo todo esto, por lo que la compañía de computadoras de marca simplemente puso su marca y modelo en esta computadora portátil como su nuevo modelo de computadora portátil. Por ejemplo, la fabricación de productos ODM por ECS G550 se utiliza en diferentes marcas y modelos de computadoras portátiles como TCL610, ChangCheng E2000, FangZheng T5800D, etc.

Podemos decir que la mayoría de las compañías de computadoras portátiles están utilizando el producto OEM y ODM para construir su computadora portátil ahora. Todas estas empresas de producción de portátiles OEM y ODM son de Taiwán y su base de fabricación está en China. La popular empresa OEM y ODM como: Compal, QUANTA, Wistron, Inventec y Pegatron. Estas empresas OEM tienen un gran porcentaje de mercado en la producción de placas base para portátiles. El fabricante OEM de segunda línea como: MITAC, Clevo, FIC, MSI, ECS, Flextronics, Foxconn, Topstar, etc.

En el mantenimiento de portátiles podemos ver diferentes marcas y modelos de ordenadores portátiles enviados a reparar. Después de desmantelar la computadora portátil y encontrar diferentes marcas y modelos de computadora portátil, pero también usan la misma placa base de la computadora portátil. Entonces, sus circuitos de placa base, secuencia de tiempo y pasos de reparación también son los mismos. Necesitamos saber cómo identificar el número de pieza de la placa base de la computadora portátil y su fabricante OEM por qué compañía.

2.1: Cuantos

QUANTA es uno de los principales fabricantes de placas base para portátiles OEM. Su placa base de computadora portátil OEM está siendo utilizada por grandes compañías de computadoras portátiles como: Dell, HP, Lenovo, Apple, etc.

El número de pieza de la placa base de la computadora portátil Quanta OEM comienza con DA o DAO. Su número de parte es DA o DAO y entre MB con 3 dígitos o 4 dígitos.

La placa base Quanta p/n modelo CH3 se muestra en la figura 2-1. En este modelo de diagrama esquemático de la placa base de la computadora portátil, puede encontrar el "PROYECTO: CH3" en la parte inferior derecha, como se muestra en la figura 2-2.



Figura 2-1: Número de pieza de la placa base Quanta CH3

Capítulo 3

La arquitectura de la

placa base del ordenador portátil

Ahora, el conjunto de chips utilizado por la computadora portátil convencional en el mercado es solo de dos fabricantes. El Intel y AMD Intel es el dominio absoluto. Una vez que el nVIDIA más popular abandonó la industria del chipset en 2010, en el mercado, los productos de computadoras portátiles con chipset nVIDIA son pocos.

3.1: La arquitectura de Intel Double Bridges (GM/PM45 y menos)

La arquitectura Intel Double Bridge incluye el chipset 855-GM/PM45. En la arquitectura Intel Double Bridge, su CPU y North Bridge están conectados a través del FSB (Front Side Bus) y North Bridge también controla la memoria, la tarjeta gráfica discreta PCI-E 16X y la interfaz de salida de pantalla.

El autobús de North Bridge y South Bridge conectado se llama HUBLINK antes de. Pero ahora se renombró a DMI (Direct Media Interface) y su velocidad de transmisión aumentó mucho más rápido.

South Bridge es una interfaz de extensión de periféricos de control, principalmente en lo siguiente:

USB: Los dispositivos en la línea USB son interfaz USB, cámara, Bluetooth, etc.

Tarjeta de audio: MODEM y la tarjeta de audio están en la misma línea.

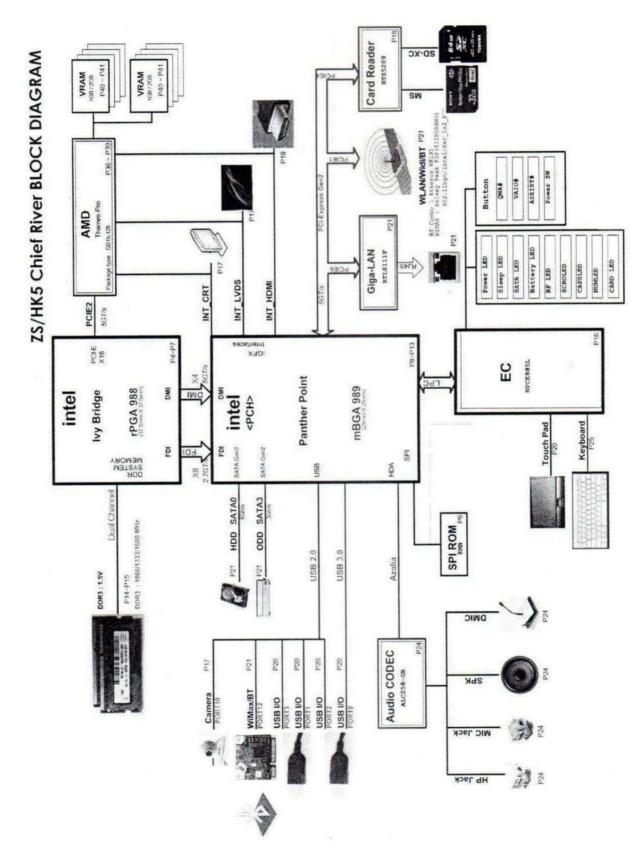


Figura 3-2: La arquitectura del chipset Intel HM75

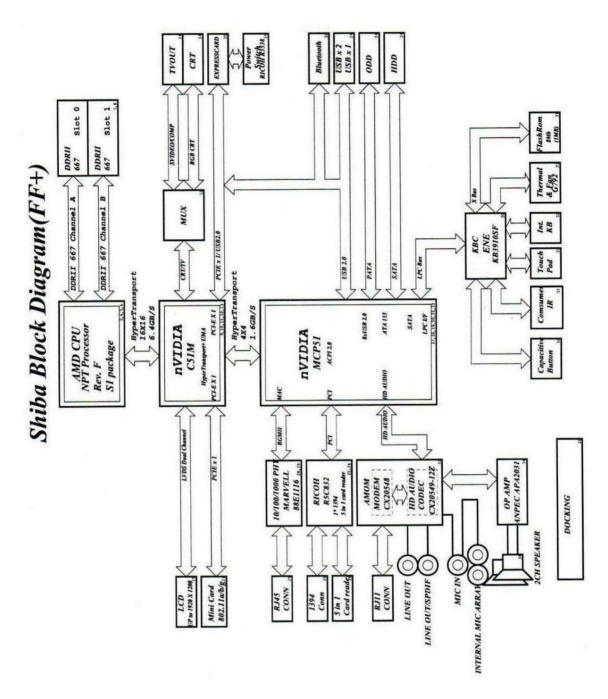


Figura 3-5: La arquitectura del chipset nVIDIA C51M

4.9.2 Cuantos

Algunos de los nombres/símbolos de señales comunes sobre la placa base Quanta se muestran en la tabla 4-2.

Nombres/símbolos de señales	Descripción
VENIR	El voltaje del punto común
ACIN, ACOK	Detección de adaptador de corriente
3V_AL, 5V_AL, VL	Fuente de alimentación lineal de 3V, 5V
+3VPCU, +5VPCU	Fuente de alimentación de reserva CE
3V_S5	El voltaje bajo la condición de S5; La fuente de alimentación de South Bridge; Abierto por EC después del interruptor de gatillo.
+3VSUS, +5VSUS	El voltaje bajo la condición de S3; Fuente de alimentación de memoria; Enviado por EC y abierto por SUSON.
NBSWON#	Señal de disparo para encendido; Presione la tecla de encendido para producir una señal altabaja alta a EC.
DNBSWON#	EC envió una señal de activación efectiva alta-baja-alta al South Bridge PWRBTN#.
SLP_S3#, SLP_S4#	La señal del controlador ACPI enviada por South Bridge se usa para abrir el voltaje cuando se enciende la alimentación, y también se usa para apagar el voltaje cuando se apaga la energía.
S5_ON	La señal de apertura del voltaje de reserva de South Bridge enviada por EC; Su uso para convertir la PCU al voltaje S5.
PISO	Después de que EC reciba SLP_S5# del South Bridge, luego produciendo S3

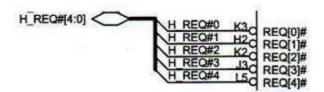


Figura 6-13: Diagrama de circuito de señal similar

6.2: El uso del mapa de bits de punto común (Software BoardView)

yo CASTW----*.1st

CASTW es la figura de posición de punto utilizada por IBM, las características más destacadas de esta figura de posición de punto es que podemos ver la dirección real de la señal. El rojo indica que la señal está en la capa actual y el amarillo indica que la señal está en la otra capa. Aquí, "la otra capa" se refiere al otro lado de la PCB y también a la capa intermedia de la PCB. Aquí están las operaciones de uso común y el menú contextual que se muestra en la figura 6-14.

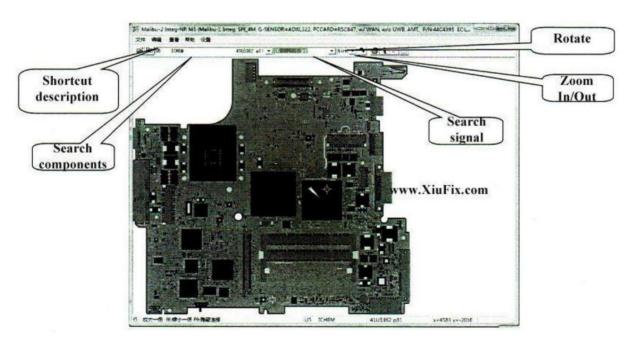


Figura 6-14: La captura de pantalla del software IBM BoardView (figura de la posición del punto)

En segundo lugar, observe la arquitectura, en las máquinas que se pueden reparar en el mercado actual, hay cuatro tipos de formas de conexión para EC y BIOS, como se muestra en la figura 7-3.

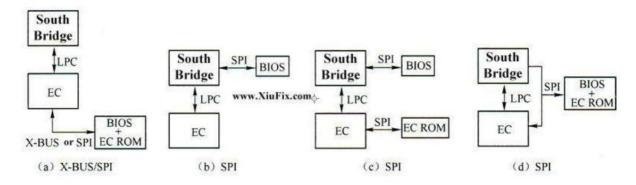


Figura 7-3: El gráfico relacional de EC y BIOS

En primer lugar, BIOS se conecta a EC a través de X-BUS y bus SPI, y luego EC se conecta a South Bridge a través de LPC, en general, en este caso, el código EC se coloca en BIOS, es decir, comparte un chip con BIOS.

En segundo lugar, BIOS se conecta al South Bridge a través del bus SPI, no hay ROM bajo EC, usa su propia ROM interna. Común en ThinkPad y Apple, algunos modelos de la última Lenovo también usan esta forma.

En tercer lugar, el BIOS principal se conecta al South Bridge a través del bus SPI, cuelga un chip ROM SPI debajo de EC para almacenar el CÓDIGO EC, tal EC no viene con el programa.

En cuarto lugar, EC y South Bridge conectan BIOS a través del bus SPI, tal EC no viene con el programa.

7.2: La función y condiciones de trabajo del BIOS

BIOS es el programa que proporciona el nivel más bajo y el control de hardware más directo en el sistema informático. Controla el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida del sistema informático, y es un concentrador conectado al programa de software y al dispositivo de hardware. Para la PC, B1OS incluye el teclado de control, la pantalla de visualización, la unidad de disco, el dispositivo de comunicación en serie y algunas otras funciones del código. La tecnología informática se desarrolla hoy en día, hay todo tipo de nuevas tecnologías, muchas de las técnicas de la parte del software es usar BIOS para administrar

Capítulo 8

El proceso de trabajo básico de la computadora portátil

Como mantenimiento profesional de computadoras portátiles, el personal, además de tener un cierto conocimiento básico, también debe comprender el proceso de trabajo y el tiempo estándar del chipset Intel de la computadora portátil y otros conocimientos de teorías de mantenimiento. Este capítulo se centra en el proceso de arranque y el tiempo estándar de Intel.

8.1: El proceso general de arranque de la computadora portátil Computadora

El proceso de trabajo de la computadora portátil sigue una cierta secuencia. En la reparación de la computadora portátil, en la mayoría de los casos, Timing se aplica en la parte de encendido en el arranque del sistema, también llamado Power Sequence. Se refiere principalmente a una placa base de computadora portátil que ha pasado del modo de espera a la señal de reinicio de la CPU. Literalmente, el tiempo es tiempo y secuencia. La placa base pasa del modo de espera al encendido y luego al trabajo de la CPU, sentimos que es poco tiempo. Es casi un segundo, pero en el trabajo de la placa base, sucederán muchas cosas en un segundo, desde el voltaje de espera produciendo. para presionar el interruptor, y la placa base recibió la señal del interruptor, luego para enviar cada voltaje de trabajo. Y la placa base hizo tanta acción; obedecerá estrictamente a un orden establecido, es decir, en el proceso de estos pasos, si no se completa el primer paso. Entonces el siguiente paso es no empezar. Y hay un requisito de tiempo estricto entre cada paso, algunos tendrán una precisión de unos pocos milisegundos, por ejemplo, la generación de señales PWRGD requiere que cada voltaje se estabilice en aproximadamente 5 ms.

De la introducción anterior, podemos ver que el tiempo tiene un significado muy importante para el funcionamiento normal de una placa base, la falla más común, como falta de electricidad, arranque y otros, tienen una relación importante con el tiempo. Se puede decir que si domina el tiempo, entonces tiene una idea básica de mantenimiento para todo tipo de fallas de la computadora portátil.

8.1.1 Proceso de arranque difícil y temporización estándar del chipset Intel

1. Proceso de arranque difícil en general.

El proceso de arranque de la computadora portátil con chipset Intel (por debajo de la serie 4) es el siguiente:

- (a) Sin ningún suministro de energía de equipo eléctrico (sin batería y sin energía), a través de una batería de botón de 3V para producir VCCRTC para suministrar el circuito RTC del puente sur, para mantener el funcionamiento del tiempo interno y guardar la información CMOS.
- (b) Después de enchufar la batería o el adaptador, produzca el punto común.
- (c) Luego, produzca la fuente de alimentación de reserva EC (generalmente voltaje lineal), después de que la fuente de alimentación de reserva sea normal, EC suministre energía al oscilador de cristal para producir el reloj de espera EC, el retraso de la fuente de alimentación de reserva produce un reinicio de EC, EC lee el programa Pin propio de configuración (forma de onda de selección de chip BIOS como se muestra en la figura 8-1).

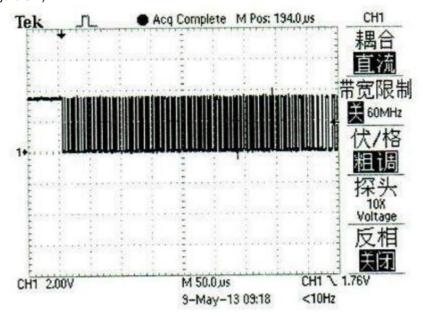


Figura 8-1: Forma de onda de selección de chip BIOS

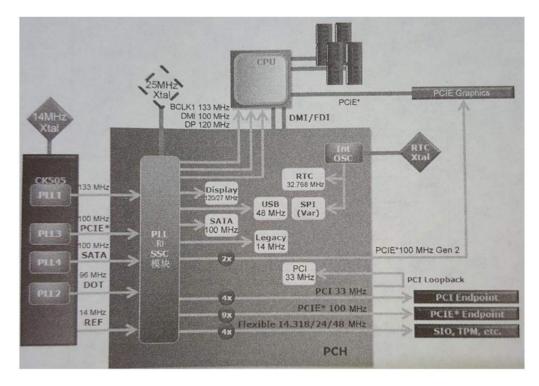


Figura 8-13

4. La distribución de la señal del reloj del chipset HM65 anterior

La distribución de la señal de reloj del conjunto de chips HM65 anterior se muestra en la figura 8-14, la característica es que debe ser cristal de 25MHz cuando el puente integra el chip del reloj.

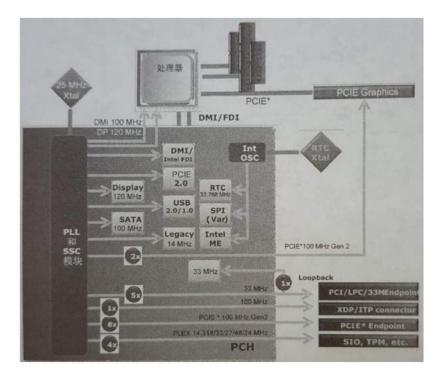


Figura 8-14: La distribución de la señal de reloj del conjunto de chips HM65 anterior

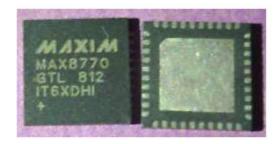


Figura 9-53: Fl objeto real de MAX8770

La definición de MAX8770 se muestra en la tabla 9-11.

Tabla 9-11: La definición de pin de MAX8770

PIN	NAME	FUNCTION							
1	CLKEN	Clock-Enable Logic Output. This inverted logic output indicates when the output voltage sensed at FB is it regulation. CLKEN is forced low during VID transitions. Except during startup, CLKEN is the inverse of PWRGD. See the Startup Timing Diagram (Figure 9). When in pulse-skipping mode (DPRSLPVR high), the upper CLKEN threshold is disabled.							
2	PWRGD	Open-Drain, Power-Good Output. After output-voltage transitions, except during power-up and power-down, if FB is in regulation then PWRGD is high impedance. During startup, PWRGD is held low and continues to be low while the part is in boot mode and until 5ms (typ) after CLKEN goes low. PWRGD is forced low in shutdown. PWRGD is forced high impedance whenever the slew-rate controller is active (output-voltage transitions). When in pulse-skipping mode (DPRSLPVR high), the upper PWRGD threshold comparator is blanked. A pullup resistor on PWRGD causes additional finite shutdown current.							
3	PSI	Logic Input to Indicate Power Usage. PSI and DPRSLPVR together determine the operating mode as shown in the truth table below. Blank the PWRGD upper threshold when the part is in skip mode. The part is forced into full-phase PWM mode during startup, while in boot mode, during the transition from boot mode to VID mode and during shutdown: DPRSLPVR PSI Mode							
4	POUT	Power-Monitor Output: VPOUT = KPWR x V(CSNpm, GNDS) x ΣV(CSP_, CSN_), where KPWR is the power monitor scale factor: CSNpm = CSN12 for MAX8771. CSNpm = CSN2 for MAX8770/MAX8772. POUT is zero in shutdown.							
5	VRHOT	Open-Drain Output of Internal Comparator. VRHOT is pulled low when the voltage at THRM goes below 1.5V (30% of V _{CC}). VRHOT is high impedance in shutdown.							
6	THRM	Input of Internal Comparator. Connect the output of a resistor- and thermistor-divider (between Vcc and GND) to THRM. Select the components such that the voltage at THRM falls below 1.5V (30% of Vcc) at desired high temperature.							
7	TIME	Slew-Rate Adjustment Pin. Connect a resistor R_{TIME} from TIME to GND to set the internal slew rate: Slew rate = $(12.5 \text{mV/µs}) \times (71.5 \text{k}\Omega_{-}/R_{TIME})$ where R_{TIME} is between 35.7k Ω and 178k Ω . This slew rate applies to transitions into and out of the low-power pulse-skipping modes (and to the transition from boot mode to VID mode. The slew rate for startup and shutdown is 1/8 this value. If the VID DAC inputs are clocked, the slew rate for all other VID transitions is set by the rate at which they are clocked, up to a maximum slew rate equal to the one set by R_{TIME} as defined above.							
8	TON	Switching-Frequency Setting Input. An external resistor between the input power source and TON sets the switching period (Tsw = $1/fsw$) per phase according to the following equation: $Tsw = C_{TON} \left(R_{TON} + 6.5k\Omega\right)$ where $C_{TON} = 16.26pF$. TON is high impedance in shutdown.							
9	CCV	Integrator Capacitor Connection. Connect a 470pF x (2/n _{TOTAL}) x 300kHz/f _{SW} capacitor from CCV to GNI to set the integration time constant. The integrator is internally disabled when the part is in skip mode and the output is above regulation.							

0	1	1	1 -	S	0	0	0.750	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0.737 5	1	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	0	0.725	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0.712 5	1	1	1	1	1	1	1	0

El circuito de aplicación de MAX8770 se muestra en la figura 9-59, varias condiciones de trabajo clave se indican en la figura:

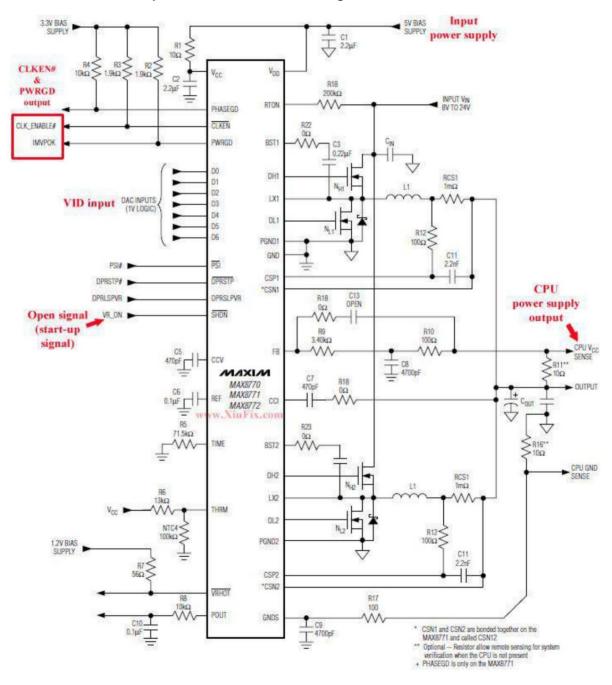


Figura 9-59: La figura de aplicación típica de MAX8770

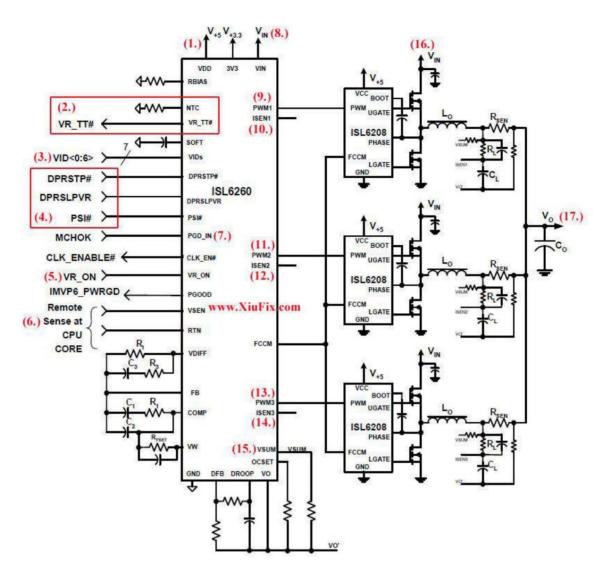


Figura 9-65: El diagrama de aplicación simplificado y el pin clave de ISL6260

Nota:

- (1.) = La fuente de alimentación principal del chip
- (2.) = Medición de temperatura e instrucción de sobretemperatura
- (3.) = VID
- (4.) = Control de suspensión y ahorro de energía
- (5.) = Apertura (puesta en marcha)
- (6.) = La detección de voltaje
- (7.) = La condición de BUENO
- (8.) = fuente de alimentación del módulo CLK_EN#
- (9.) = Salida de forma de onda cuadrada de primera fase

Capítulo 12

Análisis de COMPAL OEM Circuito de la placa base del portátil

La mayor característica de la placa base diseñada por Compal es el aislamiento protector y el circuito de reserva. la secuencia de encendido y el circuito RTC es casi la secuencia estándar. Este capítulo presenta tres tipos de circuitos de aislamiento de protección Compal. Luego explique uno de los circuitos de reserva de Compal.

12.1: Análisis del aislamiento de protección Compal LA-5891P y el circuito de reserva

En esta sección, se toma como ejemplo Compal LA_5891P para analizar el aislamiento de protección y el circuito de reserva.

1. El circuito de aislamiento de protección

Inserte el adaptador, a través de la alimentación se conecta a PJPI, y produce VIN, 19V a PL24, se muestra en la figura 12-1. La figura de la interfaz de alimentación de la placa base Compal se muestra en 12-2.

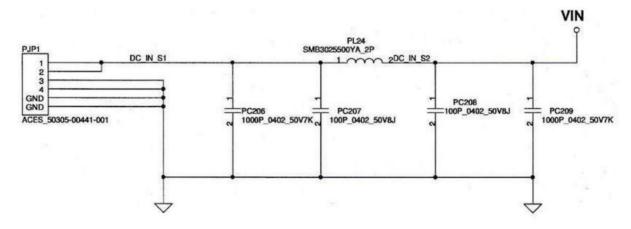


Figura 12-1: La producción de VIN

Capítulo 13

Análisis de INVENTEC Placa base para portátil OEM Circuito

Inventec suele ser OEM para HP. En este capítulo, como DosXX Dunkel 1.0 (HP_6510b) un ejemplo para explicar parte del circuito de Inventec, el circuito de este tipo se completa básicamente con los componentes independientes, EC rara vez participó en el control de voltaje. Es muy significativo para el estudio del análisis del circuito.

13.1: Análisis del circuito de aislamiento protector Inventec DosXX Dunkel 1.0

El voltaje +VADP de la interfaz del adaptador JACK1 necesita a través de Q507 y Q514 para alcanzar el punto común +VBATR, estos dos tubos de efecto de campo están controlados por ADP_EN#, BATCAL#, ACDRV#, como se muestra en la figura 13-1.

En la figura 13-1, Q507 es el canal P. Debe tener dos condiciones para conducir: ADP_EN# es bajo, BATCAL# es alto, y el origen de las mismas se muestra en la figura 13-2.

El análisis del circuito en la figura 13-2:

(1) LIMIT_SIGNAL es un voltaje de aproximadamente 7 V desde el pin central del adaptador, + VADP es el voltaje del adaptador de 19 V, a través de R108 y R105, R104 presión parcial, luego

obtiene 5,9 V de 2 pines, y menos de 7 V de 3, el comparador emite el ADP_ ID de alto nivel y luego lo envía a EC para la detección del adaptador.

- (2) VADP a través de R108, R105 y R104, la presión parcial de 4,8 V para enviar a 5 pines es inferior a 7 V de 6 pines, el comparador emite el nivel bajo ADP_EN#.
- (3) El nivel bajo de ADP_EN# hace que Q7 se corte, ADP_EN es alto. envía a EC, porque no hay energía en este momento, SLP_S3#_3R es bajo, Q545 está cortado, BATCAL# se eleva para obtener el nivel alto por el voltaje del adaptador a través de R9252.

Entonces el Q507 se realiza con éxito y produce +ADPBL.

En la figura 13-1, si Q514 se conduce por completo, necesita el nivel bajo de ACDRV# enviado por U5 (BQ24703), el proceso específico es que +VADPBL en el lado izquierdo de Q514 a través del diodo del cuerpo entre el polo D y El polo S y D510 suministra la pequeña corriente al punto común +VBATR, como se muestra en la figura 13-3.

+VBATR renombrado para ser +VBATP después de cruzar el cable de puente PAD6, suministrado al VIN del chip de administración de energía en espera TPS51120, como fuente de alimentación principal. se muestra en la figura 13-4. Debido a que EN3 y EN5 del chip están colgados en el aire, de acuerdo con la definición de pin de TPS51120, EN3 y EN5 colgados en el aire producirán automáticamente VREG3 y VREG5. VREG5 retrocede para suministrar energía. a V5FILT, y produce el voltaje de referencia con 2VREF.

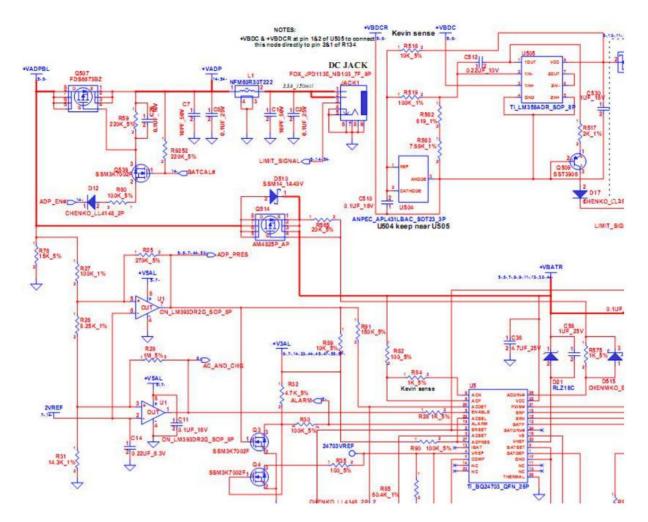


Figura 13-1: El circuito de producción de punto común

(Para obtener detalles más claros, consulte su diagrama esquemático completo en la sección de bonificación)

capitulo 14

Análisis de Intel PCH Secuencia (i3/i5/i7)

PCH es el concentrador del controlador de la plataforma. Intel PCH es el conjunto de chips de puente único de la empresa Intel. El producto de la PCH de primera generación es la serie Intel 5, como Intel HM55, etc. coincide con la CPU 13/15/17 de primera generación; La segunda generación y la tercera generación son las series Intel 6 e Intel 7, coinciden con la CPU 13/15/17 de segunda generación y tercera generación, estas dos generaciones son casi iguales, la CPU se usa en común. La cuarta generación más nueva que se ha lanzado es la serie Intel 8. El chip PCH tiene todas las funciones del ICH original, también tiene la función de gestión del motor del MCH original. No importa llamar a PCH el Puente Norte o el Puente Sur. En este capítulo, presentamos principalmente la característica principal de Intel 5 series.6 series y 7 series series.

14.1: Acerca de Intel ME e Intel AMT

Intel ME es Intel Management Engine, es el hardware independiente insertado, el firmware North Bridge o PCH.ME (ME FW) y la placa base del BIOS generalmente se mantienen en el mismo chip, pero son independientes entre sí. La arquitectura del firmware Intel ME y ME se muestra en la figura 14-1.

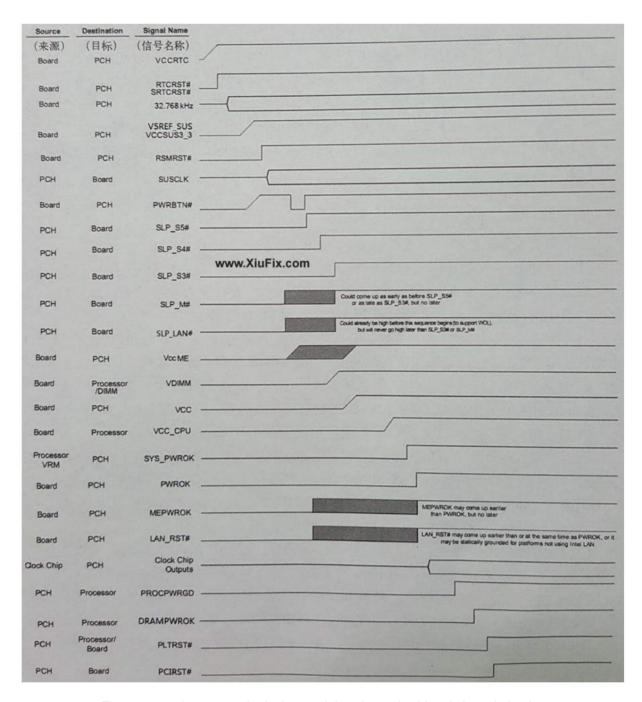


Figura 14-10: La secuencia de tiempo del conjunto de chips de la serie Intel 5

VCCRTC: fuente de alimentación de 3V enviada desde la placa base al puente PCH, suministra energía al circuito RTC del puente, para guardar el parámetro CMOS.

RTCRST#/SRTCRST#: nivel alto de 3 V enviado desde la placa base al puente, la señal de reinicio del circuito RTC comienza desde ICH9, hay dos reinicios.

32.768kHz: el cristal de 32.768 kHz al lado del puente, el puente suministra la potencia al cristal y el cristal proporciona la frecuencia al puente.

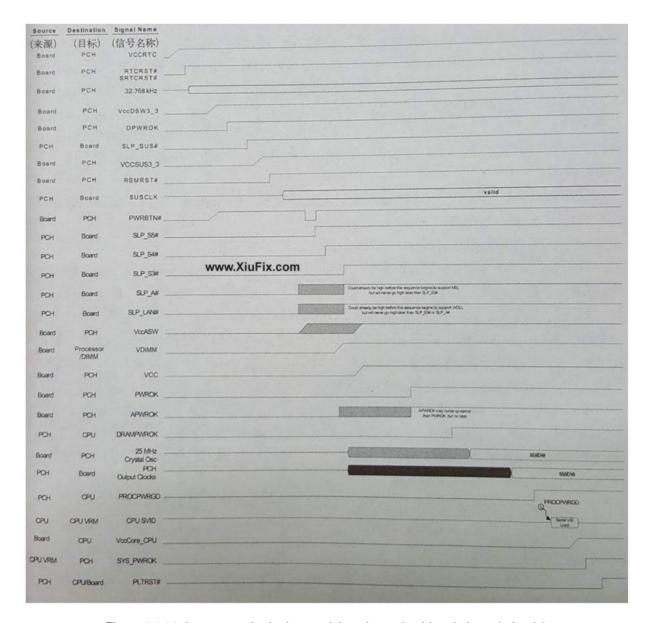


Figura 14-11: La secuencia de tiempo del conjunto de chips de la serie Intel 6

VCCRTC: envió una fuente de alimentación de 3 V al puente PCH desde la placa base, suministra energía al RTC del puente, para guardar el parámetro CMOS.

RTCRST#/SRTCRST#: envió 3V de alto nivel al puente desde la placa base, la señal de reinicio del circuito RTC. Comienza desde ICH9 y hay dos reinicios.

32.768kHz: cristal de 32.768 kHz al lado del puente, el puente suministra la potencia al cristal y el cristal proporciona la frecuencia al puente.

VCCDSW3_3: la placa base proporciona la fuente de alimentación del pozo de suspensión profunda al puente, 3-3V. Cuando no es compatible con la suspensión profunda, este voltaje se conecta con VCCSUS3_3.

Capítulo 15

Análisis de ASUS K42JR (HM5x) Secuencia de temporización

ASUS K42JR utiliza el chipset de la serie Intel 5. Analizaremos la secuencia de tiempo de espera y encendido en el modo adaptador, porque el circuito RTC es casi el mismo, por lo que no lo explicaremos en este capítulo.

15.1: El estado de espera

Primero, la inserción del adaptador, salidas A/D_DOCK_IN, se muestra en la figura 15-1.

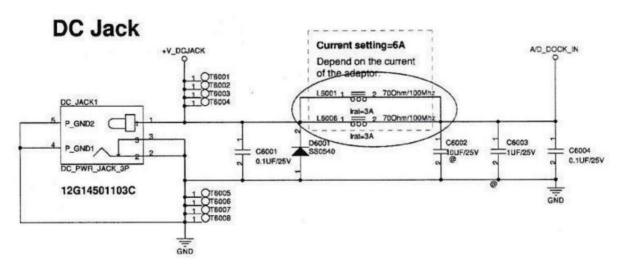


Figura 15-1: La captura de pantalla del circuito de interfaz del adaptador

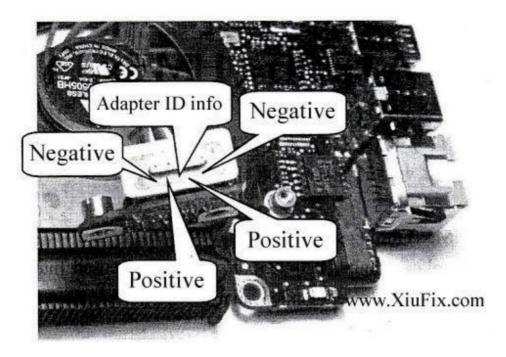


Figura 16-2: El tipo de adaptador de Apple

PPDCIN_G3H a través del diodo del cuerpo de Q7080 para producir PPDCIN_G3H_OR_PBUS se muestra en la figura 16-3. (En el modo de batería, la batería a través del diodo del cuerpo de Q7055 y a través del tubo superior Q7030 del circuito de carga, luego a través del diodo del cuerpo de Q7085D para suministrar energía a PPDCIN_G3H_OR__PBUS).

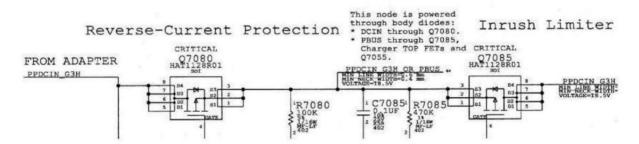


Figura 16-3: El circuito de producción de PPDCIN_G3H_OR_PBUS

PPDCIN_G3H_OR_PBUS suministra la energía al VIN de U6990 (IT3970), y se agrega a EN directamente, el chip emite PP3V42_G3H, se muestra en la figura 16-

4. Este es un regulador de conmutación reductor, interno integra el amplificador y los diodos de sujeción. La definición de pin VIN significa la fuente de alimentación, EN significa la apertura y RT significa la configuración de oscilación. BOOST significa pin de correa de arranque de inicio, SW significa pin de fase/salida. FB significa retroalimentación, BD conecta el diodo de refuerzo interno y el regulador de voltaje.

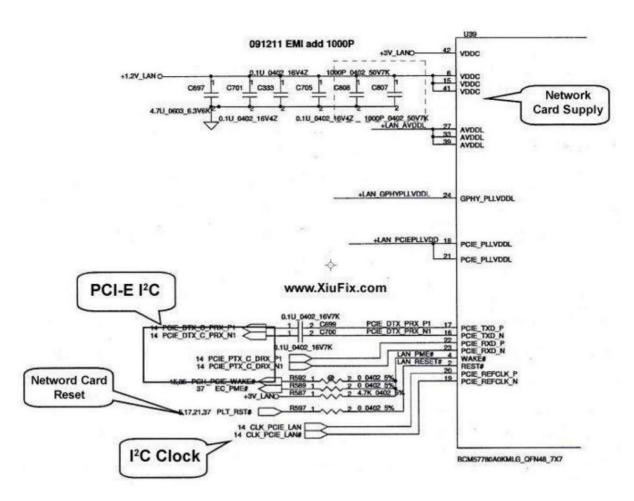


Figura 21-41: La captura de pantalla de las condiciones básicas de funcionamiento de la tarjeta de red

(2) El cristal de 25MHz de la tarjeta de red, se muestra en la figura 21-42.

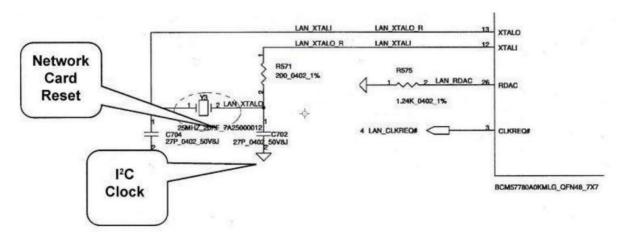


Figura 21-42: Cristal de 25 MHz de la tarjeta de red

Muy recomendable otra gran información de reparación relacionada para usted:

Con toda esta excelente información de reparación, lo ayudará a solucionar problemas y reparar los dispositivos electrónicos: (Haga clic en la portada del libro electrónico para obtener más detalles)

1) Los grandes libros electrónicos de reparación electrónica:



2) Kent Liew Best of OLED/LED/LCD/Plasma TV Repairing Ebooks:



a) http://www.LCDRepairGuide.com

Este es un sitio web profesional de reparación de televisores OLED/LED/LCD/Plasma. Incluyó todos los excelentes consejos y trucos de reparación, por ejemplo, el método de autocomprobación de la fuente de alimentación, el método de modificación del panel, el método de derivación de retroiluminación, los secretos de reparación de la placa base de TV, los secretos de reparación de la placa T-con (sección de control de tiempo), etc.

b) Sitios de membresía:

El sitio de membresía contiene los manuales de servicio, manuales de capacitación, diagrama esquemático, boletín de servicio, etc. Para obtener más detalles, visite:

http://www.LCD-Television-Reparación.com